

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
6. September 2002 (06.09.2002)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 02/068245 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **B60R 16/02,**
H05K 3/10

(21) Internationales Aktenzeichen: **PCT/EP02/01896**

(22) Internationales Anmeldedatum:
22. Februar 2002 (22.02.2002)

(25) Einreichungssprache: **Deutsch**

(26) Veröffentlichungssprache: **Deutsch**

(30) Angaben zur Priorität:
101 09 087.0 24. Februar 2001 (24.02.2001) **US**

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): **LEONI BORDNETZ-SYSTEME GMBH & CO**
KG [DE/DE]; Marienstrasse 7, 90402 Nürnberg (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **ZAHRADNIK, Franz**

[DE/DE]; Von-Weber-Strasse 51, 91074 Herzogenaurach
(DE). **HARTMANN, Uli** [DE/DE]; Mathilden Strasse 11,
33098 Paderborn (DE). **GÖTZ, Knuth** [DE/DE]; War-
muhsreuth 43, 95511 Mistelbach (DE). **REICHINGER,**
Gerhard [DE/DE]; Schwabacher Strasse 16, 91126 Red-
nitzhembach (DE).

(74) Anwalt: **TERGAU & POHL**; Mögeldorf Hauptstrasse
51, 90482 Nürnberg (DE).

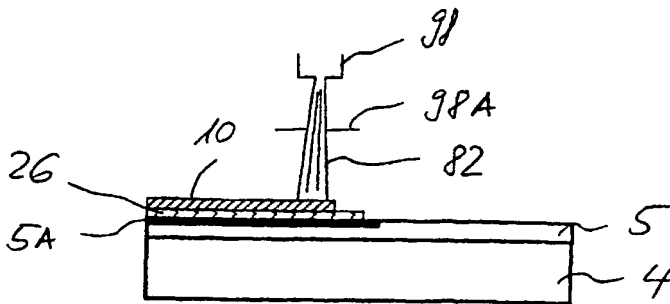
(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AL, AM, AT, AU,
AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK,
EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN,
IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV,
MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US,
UZ, VN, YU, ZA, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH,
GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW),
curasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING A MOULDED COMPONENT COMPRISING AN INTEGRATED CONDUCTOR
STRIP AND MOULDED COMPONENT

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES FORMBAUTEILS MIT EINER INTEGRIERTEN LEITERBAHN
UND FORMBAUTEIL



(57) Abstract: The invention relates to a method for producing a moulded component (2A-2G) comprising an integrated conductor strip (10), wherein a conductor strip (10) is produced on a carrier component (4) particularly by flame injection or cold gas injection. The surface of the carrier component (4) is treated in a selective manner corresponding to a predetermined path of the conductor strip (10) so that the surface areas thereof have different adhesions. A germ layer is applied to the path of the conductor strip (10), whereupon the conductor strip (10) is subsequently

placed thereon. It is therefore possible to produce a moulded component (2A-2G) comprising an integrated conductive strip mould in a very flexible and economical manner. In automobile industries, special requests from the clients can be met in a fast and efficient manner by altering the layout of the conductor strip.

(57) Zusammenfassung: Bei einem Verfahren zum Herstellen eines Formbauteils (2A-2G) mit einer integrierten Leiterbahn (10) wird auf einem Trägerbauteil (4) insbesondere mit Hilfe des Flammsspritzens oder des Kaltgasspritzens eine Leiterbahn (10) erzeugt. Hierzu wird die Oberfläche des Trägerbauteils (4) selektiv entsprechend einem vorgesehenen Verlauf der Leiterbahn (10) behandelt, so dass die oberfläche Bereiche unterschiedlicher Haftung aufweist. Im vorgesehenen Verlauf der Leiterbahn (10) wird eine Keimschicht (26) aufgetragen, auf die dann wiederum die eigentliche Leiterbahn (10) aufgebracht wird. Dadurch ist ein sehr flexibles und kostengünstiges Herstellen eines Formbauteils (2A-2G) mit einem integriertem Leiterbahnmuster möglich. Insbesondere im Kraftfahrzeug-Bereich können spezielle Kundenwünsche zeitnah und problemlos durch ein geändertes Leiterbahnlayout verwirklicht werden.

WO 02/068245 A1